DWG. NO. SD-52629-1051

注記
NOTES.

1. 材料
MATERIAL
ハウジング：ガラス入りLCP UL94V-0材 色：黒
HOUSING: G.F.LCP UL94V-0 COLOR:BLACK
ターミナル：リン青銅
TERMINAL: PHOSHOR BRONZE

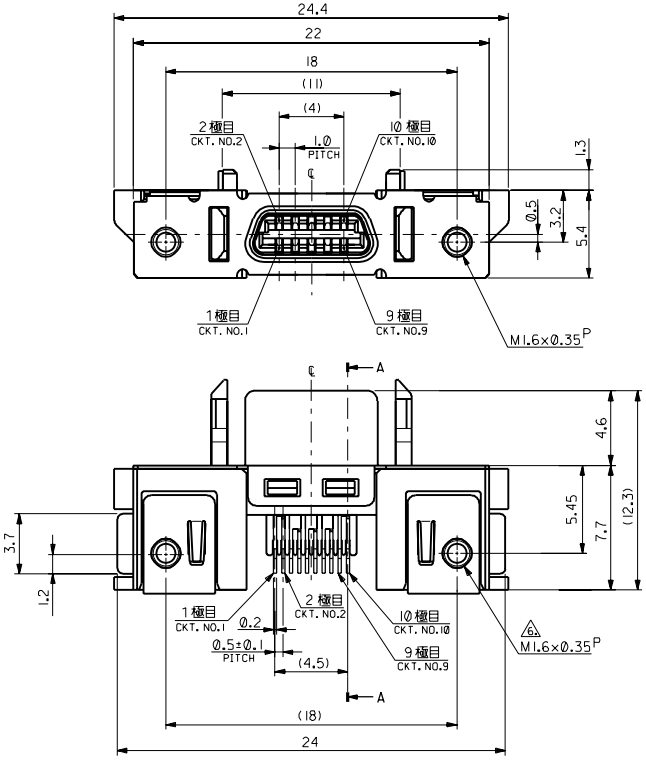
2. メッキ仕様
PLATING
接点部 ：金メッキ 0.5μm MIN.
CONTACT AREA:GOLD
半田付け部 ：半田メッキ 1.0μm MIN.
SOLDER AREA:TIN-LEAD
下地メッキ ：ニッケル下地 2.0μm MIN.
UNDER PLATING AREA:NICKEL
シールド部 ：ニッケルメッキ 2.0μm MIN.
SHIEDED AREA :NICKEL

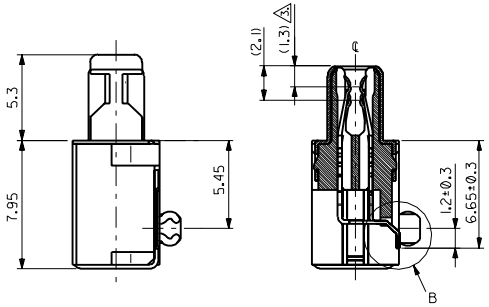
3. 両端各2端子。（計4端子）
2 TERMINAL AT BOTH ENDS (TOTAL:4 TERMINALS)

4. 推奨基板厚 t：1.0±0.1
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS t:1.0±0.1

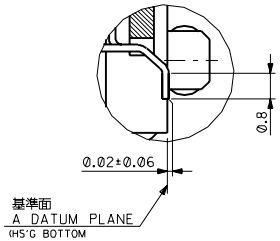
5. 位置決めペグ穴
POSITION HOLE (PEG HOLE)

6. コネクタは、必ず半田付け前にねじ止めのこと。
TO BE SCREW LOCK CONNECTOR BEFORE SOLDERING.

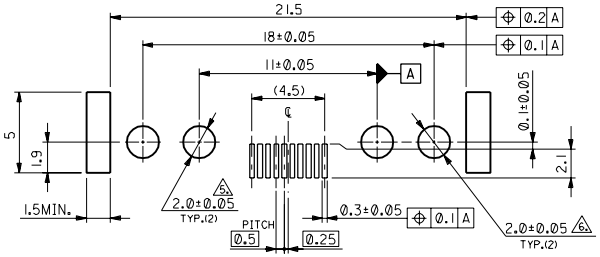




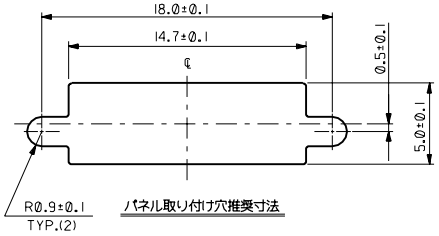
SECTION A-A



DETAIL B
(SCALE:10-1)



表面実装基板推奨寸法
RECOMMENDED P.C.BOARD DIM.'S FOR SMT



パネル取り付け穴推奨寸法

角度 ANGLE	±3°					材料 MATERIAL	
30以上 OVER	±0.3					仕上げ FINISH	
10以上 OVER 30未満 UNDER	±0.25					適用電線範囲 WIRE RANGE	
10未満 UNDER	±0.2	0	新規作成 PROPOSED	S.I. Y.I.	99/07/30	被覆外径 INS. RANGE	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	DRAWN BY 99/02/10 S. Ishikawa / CHK'D BY Y.Ota / APP'D BY	尺度 SCALE 5-1

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
1.0 mm PITCH
I/O REC HS'G ASS'Y

DWG. NO. SD-52629-1051 REV 0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEXJAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-31

S52629MA.DGN

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING